



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
板对板配置	平行

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μm
接合插针直径	.63 mm[.025 in]



端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.027 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器高度	6.2 mm[.244 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
堆叠高度	9 mm[.354 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Reel
------	------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1241150-3 3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER	TE 产品编号 826629-3 3P AMPMODU II	TE 产品编号 826647-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 826646-3 3P AMPMODU II STIFT LEI
TE 产品编号 826652-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 826631-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 826648-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 215267-3 AMPMODU,BREAK-AWAY



TE 产品编号 826630-3
3P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号 826654-3
3P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号 826655-3
3P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号 966306-3
MOD2 ST-LEI SMD 3P

TE 产品编号 966710-3
MODU II PIN HEADER, SGL ROW,
SMD- 3 POS

该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190

板对板接头和插座(347)

客户还购买了

TE 产品编号1658683-1
HDP-22,RCPT,SIZE 3,44 POSN

TE 产品编号1-178141-2
DYNAMIC CONN 6P V HDR ASSY

TE 产品编号MS583702BA01-50
MS5837-02BA01 2BA T&R PRESSURE
SEN

TE 产品编号1-1734592-6
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 16P

TE 产品编号1241152-4
4P HV100 REC. CON, SMD, GOLD,
BLISTER

TE 产品编号1241152-5
5P HV100 REC. CON, SMD, GOLD,
BLISTER

TE 产品编号1624117-5
BMB-A 0805 120R N4

TE 产品编号1-1624117-7
BMB-R 0805 600R



文档

产品图纸

3P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1241152-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1241152-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1241152-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

MD_1241152-3_07162013026_dmtec

英文版本

MD_1241152-3_07162013026_dmtec

英文版本